公司代码:688362 公司简称:甬矽电子

甬矽电子（宁波）股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

2023年,受宏观经济增速放缓、国际地缘政治冲突和行业周期性波动等多重负面因素影响,以消费电子为代表的终端市场整体需求疲软,半导体行业需求出现较大波动,整体出现周期性下行。根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)发布的数据,2023年全球半导体市场规模估计为5,201亿美元,同比下降9.4%,较2022年出现下滑。作为专注于中高端先进封测领域的封测企业,公司努力克服整体行业下行的不利影响,持续关注客户需求,围绕客户提供全方位、高质量服务,通过增强新客户拓展力度、加强新产品导入力度、提升产品品质、缩短供货周期、降低产品成本等多种方式,提升客户满意度和自身竞争力,2023年公司稼动率整体呈稳定回升趋势。在公司全体员工的持续努力下,公司克服了多种不利因素影响,报告期内,公司实现营业收入239,084.11万元,较上年同期增长9.82%;但由于下游客户整体订单仍较为疲软,部分产品线订单价格承压,导致公司毛利率较去年同期仍有所下降;同时,公司二期项目建设有序推进,公司人员规模持续扩大,人员支出及二期筹建费用增加,使得管理费用同比增长71.97%;综合导致公司2023年归属于上市公司股东的净利润同比下滑167.48%。公司预计2024年营收规模将持续提升,由此带来的规模效应亦会对盈利能力产生正面影响,但若未来半导体产业持续低迷或公司投资项目产能爬坡不及预期,公司业绩可能出现不及预期或亏损的风险。

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-93,387,886.95元,截至2023年12月31日,公司母公司实现可供分配利润为人民币 322,542,911.80元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《甬矽电子(宁波)股份有限公司章程》等的相关规定,鉴于公司2023年归属于母公司股东的净利润为负,综合考虑公司的经营情况和未来资金需求,为更好地维护全体股东的长远利益,保障公司长期稳定发展,经公司审慎研究讨论,公司2023年度拟不派发现金分红,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司2023年年度利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	甬矽电子	688362	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李大林	昝红
办公地址	浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路22号	浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路22号
电话	0574-58121888-6786	0574-58121888-6786
电子信箱	zhengquanbu@forehope-elec.com	zhengquanbu@forehope-elec.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事集成电路的封装和测试业务,为集成电路设计企业提供集成电路封装与测试解决方案,并收取封装和测试服务加工费。公司封装产品主要包括“高密度细间距凸点倒装产品(FC类产品)、系统级封装产品(SiP)、扁平无引脚封装产品(QFN/DFN)、微机电系统传感器(MEMS)”4大类别。下游客户主要为集成电路设计企业,产品主要应用于射频前端芯片、AP类SoC芯片、触控芯片、WiFi芯片、蓝牙芯片、MCU等物联网芯片、电源管理芯片、计算类芯片、工业类和消费类产品等领域。

公司于2017年11月设立,从成立之初即聚焦集成电路封测业务中的先进封装领域,车间洁净等级、生产设备、产线布局、工艺路线、技术研发、业务团队、客户导入均以先进封装业务为导向。报告期内,公司全部产品均为QFN/DFN、WB-LGA、WB-BGA、Hybrid-BGA、FC-LGA等中高端先进封装形式,并在系统级封装(SiP)、高密度细间距凸点倒装产品(FC类产品)、大尺寸/细间距扁平无引脚封装产品(QFN/DFN)等先进封装领域具有较为突出的工艺优势和技术先进性。

公司为了保持先进封装技术的先进性和竞争优势,在技术研发和产品开发布局上,一方面注重与先进晶圆工艺制程发展相匹配,另一方面注重以客户和市场需求导向为目标。结合半导体封测领域前沿技术发展趋势,以及物联网、5G、人工智能、大数据等应用领域对集成电路芯片的封测需求,公司陆续完成了倒装和焊线类芯片的系统级混合封装技术、5纳米晶圆倒装技术等技术的开发,并成功实现稳定量产。同时,公司已经掌握了系统级封装电磁屏蔽(EMI Shielding)技术、芯片表面金属凸点(Bumping)技术、Fan-in技术,并积极开发Fan-out、2.5D/3D等晶圆级封装技术、高密度系统级封装技术、大尺寸FC-BGA封装技术等,为公司未来业绩可持续发展积累了较为深厚的技术储备。

(二)主要经营模式

1、盈利模式

公司主营业务为集成电路的封装与测试,并根据客户需求提供定制化的封装技术解决方案。客户提供未进行封装的晶圆裸片,公司根据客户要求的封装类型和技术参数,将芯片裸晶加工成可直接装配在PCB电路板上的芯片产品。封装完成后,公司会根据客户要求,对芯片产品的电压、电流、时间、温度、电阻、电容、频率、脉宽、占空比等参数进行专业测试。公司完成晶圆裸片的封装和芯片测试后,将芯片成品交付给客户,获得收入和利润。

(1)生产模式

公司主要专注于中高端封装和测试产品的生产,并配备了专业的高精度自动化生产设备。公司拥有专业的工程技术和生产管理团队,可以根据客户提出的各种封装测试要求及时做出响应,并根据市场需求对产品种类和产量进行快速调整。由于不同的封装种类在生产制程上存在差异,公司为了便于生产管理,同时也为了提高生产效率和产品良率,在柔性生产模式的基础上,按照封装种类对生产线进行划分。

(2)采购模式

公司采购处负责全部生产物料和生产设备的采购,采购处下设材料采购部和设备采购部,材料采购部根据公司生产所需,负责材料(直接材料、间接材料、包装材料)采购。此外,当公司制程能力不足或产能不足时,材料采购部还负责相应的外协服务采购;设备采购部根据公司生产所需以及日常耗用情况,负责设备、备品备件、耗材、工装模具等的采购。

2、销售模式

公司以直接销售为主,主要下游客户为芯片设计公司。公司接受芯片设计客户的委托订单,对客供晶圆裸片提供封装加工和成品测试服务。

除直接销售外,报告期内公司部分数字货币领域封测产品采取代理销售模式,即专门的供应链服务公司(即代理公司)同数字货币矿机生产企业签署封装测试服务协议,公司同代理公司签署封装和测试委托加工合同或公司与代理公司及矿机芯片企业签署三方协议,并同服务公司结算,封装测试好的芯片直接发给数字货币矿机芯片企业或由其自提。公司部分数字货币类产品采取代理销售模式,一方面是因为部分数字货币矿机芯片企业更多侧重于数字货币矿机整机的销售,相对缺乏半导体产业链的运营经验,需要专业的供应链服务公司提供产能预定、订单管理等运营服务;另一方面是因为数字货币价格波动巨大,矿机芯片客户订单量波动较大,为了降低客户管理成本和经营风险,公司直接同供应链服务公司进行结算。

3、研发模式

公司主要采用自主研发模式，建立了研发项目管理制度以及专利管理制度，并具有完善的研发投入核算体系。公司设有研发工程中心,下辖材料开发处、产品研发处、设计仿真处、工艺研发处、测试工程开发处和工程实验室。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)公司所属行业及确定所属行业的依据

公司主营业务为集成电路的封装和测试。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”;根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”下属的“集成电路制造(C3973)”。公司业务细分行业为集成电路封装和测试业。

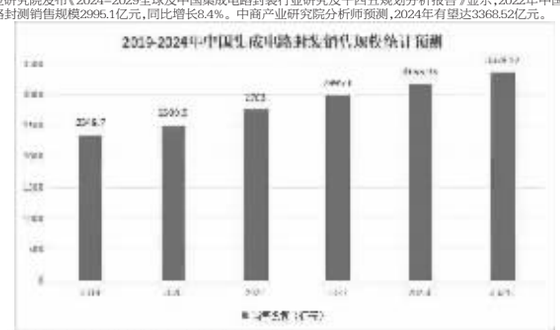
(2)行业的发展阶段与基本特点

20世纪70年代开始,随着半导体技术日益成熟,晶圆制程和封装工艺进步日新月异,一体化的IDM公司逐渐在晶圆制程和封装技术方面难以保持技术先进性。为了应对微利的市场竞争,大型半导体IDM公司逐步将封装测试环节剥离,交由专业的封测公司处理,封测行业变成集成电路行业中一个独立子行业。

20世纪90年代,随着全球化进程加快、国际分工职能深化,以及集成电路制程难度的不断提高,集成电路产业链开始向专业化的分工方向发展,逐渐形成了独立的半导体设计企业、晶圆制造代工企业和封装测试企业。在半导体产业转移、人力资源成本优势、税收优惠等因素促进下,全球集成电路封测厂逐渐向亚太地区转移,目前亚太地区占全球集成电路封测市场大约80%的份额。

2023年,受地缘政治、全球经济增速放缓等多种因素影响,全球半导体行业增速大幅放缓。根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)发布的数据,2023年全球半导体市场规模估计为5,201亿美元,同比下降9.4%。2023年初全球半导体销售低迷，下半年销售额有所回升。第四季度销售额为1460亿美元，比2022年第四季度总销售额增长11.6%,比2023年第三季度总销售额增长8.4%。摩尔定律降本收效,先进封装接棒助力AI浪潮。芯片依靠制程微缩带动单位性能成本的快速下降,带动半导体产业蓬勃大发展。芯片制程步入3nm及以下制程,摩尔定律降本效应大幅收敛，先进封装乘势而起。前道制程微缩抑或是先进封装均为在单位面积内堆叠更多芯片来获得更强的性能。先进封装内涵丰富,包括倒装焊、扇入/扇出封装、晶圆级封装、2.5D/3D封装、Chiplet等一系列概念,本质均为提升I/O密度。根据Yole数据,2023年全球封测市场规模为857亿美元,其中先进封装占比48.8%。通用大模型、AI手机及PC、高阶自动驾驶的发展均要求高性能算力，先进封装作为提升芯片性能的有效手段有望加速渗透与成长。根据市场调研机构Yole数据预测,全球先进封装市场规模将由2022年的443亿美元,增长到2028年的786亿美元,年复合成长率为10.6%。此外,先进封装的市场比重将逐渐超越传统封装,成为封测市场贡献主要增量。

近年,全球半导体产业链向国内转移,封测产业已成为我国半导体的强势产业,市场规模持续向上突破。中商产业研究院发布《2024-2029全球及中国集成电路封装行业研究及十四五规划分析报告》显示,2022年中国集成电路封测销售规模2996.1亿元,同比增长8.4%。中商产业研究院分析师预测,2024年有望达3368.52亿元。



数据来源:中国半导体行业协会、中商产业研究院整理

(3)主要技术门槛

在集成电路制程方面,“摩尔定律”认为集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔18-24个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。长期以来,“摩尔定律”一直引领着集成电路制程技术的发展与进步,自1987年的1um制程至2015年的14nm制程,集成电路制程迭代一直符合“摩尔定律”的规律。但2015年以后,集成电路制程的发展进入了瓶颈,7nm、5nm、3nm制程的量产进度均落后于预期。随着台积电宣布2nm制程工艺实现突破,集成电路制程工艺已接近物理尺寸的极限,集成电路行业进入了“后摩尔时代”。

“后摩尔时代”制程技术突破难度较大,工艺制程受成本大幅增长和技术壁垒等因素影响,上升改进速度放缓。根据市场调研机构IC Insights统计,28nm制程节点的芯片开发成本为5,130万美元,16nm节点的开发成本为1亿美元,7nm节点的开发成本需要2.97亿美元,5nm节点开发成本上升至5.4亿美元。由于集成电路制程工艺短期内难以突破,通过先进封装技术提升芯片整体性能成为了集成电路行业技术发展趋势。

封测企业需要朝着先进封装技术的发展方向,不断向晶圆级封装领域和系统级封装领域发展,不断进行技术创新、开发新产品才能适应市场变化,顺应集成电路下游应用市场集成化、小型化、智能化的发展趋势。封装领域不断涌现出诸如2.5D/3D/POP等新兴封装类型以及先进封装技术,这对于封装测试企业在新产品的研发、品质、测试方面提出了苛刻的要求,技术门槛越来越高。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

甬矽电子专注于中高端先进封装和测试业务,报告期内,公司已经与多家行业内知名IC设计企业建立了稳定的合作关系。公司为国家高新技术企业,2020年入选国家第四批“集成电路重大项目企业名单”,先后被授予“浙江省科技小巨人”、“浙江省电子信息50家成长性特色企业”、“浙江省创造力百强企业”、“浙江省上云标杆企业”“宁波市制造业‘大优强’培育企业”、“宁波市数字经济十佳企业”、“余姚市人民政府质量奖”、“2022年度宁波市管理创新提升五星级企业”、“2022年宁波市研发投入百强”等多项荣誉。公司研发中心被认定为“浙江省高新技术企业研究开发中心”公司“年产25亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目”被评为浙江省重大项目。

根据集微咨询(JW Insight)发布的2023年中国大陆半导体封测代工企业专利创新二十强榜单,公司排名第8。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着半导体制程的不断演进,工艺已接近瓶颈,以及芯片架构优化的限制,未来几年处理器性能的发展将逐步减慢,摩尔定律也将逐渐失效。因此,以Chiplet理念为代表的先进封装的技术应用将成为提高芯片性能的一种重要途径。Chiplet是指将一类满足特定功能的die(裸片),通过die-todie内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片,以实现一种新形式的IP复用。Chiplet是将原本一块复杂的SoC芯片,从设计时就按照不同的计算单元或功能单元对其进行分解,然后每个单元选择最适合的工艺制程进行制造,再将这些模块化的裸片互联起来,通过先进封装技术,将不同功能、不同工艺制造的Chiplet封装成在同一颗芯片内。目前而言,实现Chiplet的技术方式包括2.5D、3D等多种形式,如台积电、日月光等全球主要的封装厂或晶圆代工厂均已经或正在开发相关的封装形式,在先进制程受限的情况下,相关技术将有望成为我国集成电路封测行业新的突破口。Chiplet技术的发展将大大推动先进封装的市场发展。

长期来看,全球及中国集成电路产业仍将持续增长。根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测2024年,全球半导体市场将蓬勃发展,预计增长13.1%,估值将达到5880亿美元;从区域角度看,所有市场都将在2024年持续扩张,特别是美洲和亚太地区,预计将实现两位数的同比大幅增长。根据Yole预测,全球先进封装市场预计将在2019-2025年间以6.6%的复合年增长率增长,到2025年将达到420亿美元;同时,与传统封装相比,先进封装的应用正不断扩大,预计到2026先进封装将占到整个封装市场规模的50%以上。

我国是全球最大的集成电路需求市场,特别是对价值较高的高端芯片进口依赖较大,芯片进口金额远超出口金额，这表明我国在芯片领域存在较大的贸易逆差。根据国家统计局发布的2023年国民经济和社会发展统计公报，我国2023年全年集成电路产量3,514.4亿块，比上年提升6.9%；全年集成电路出口2,678亿个，比上年下降1.8%,金额为9,568亿元,比上年下降5.0%,在我国主要商品出口中金额排名第四;集成电路进口4,796亿个,比上年下降10.8%,金额为24,591亿元,比上年下降10.6%,在我国主要商品进口中金额排名第一。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	12,330,906,165.46	8,320,726,323.62	8,318,700,069.06	48.20	4,632,600,117.09	4,632,186,187.28
归属于上市公司股东的净资产	2,448,597,504.62	2,554,143,218.39	2,553,847,009.77	-4.13	1,373,119,281.15	1,373,092,019.81
营业收入	2,390,841,120.27	2,176,992,689.58	2,176,992,689.58	9.82	2,054,615,247.43	2,054,615,247.43
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,382,294,225.34	2,154,873,373.35	2,154,873,373.35	10.55	2,041,103,021.00	2,041,103,021.00
归属于上市公司股东的净利润	-93,387,886.95	138,400,419.38	138,131,472.10	-167.48	322,102,165.93	322,074,904.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-161,909,756.67	59,308,286.37	59,039,339.09	-373.00	292,607,936.58	292,580,675.24
经营活动产生的现金流量净额	1,071,479,586.66	899,615,766.86	899,615,766.86	19.10	818,627,146.81	818,627,146.81
加权平均净资产收益率(%)	-3.75	9.02	9.00	减少12.77个百分点	33.64	33.64
基本每股收益(元/股)	-0.23	0.39	0.39	-158.97	1.05	1.05
稀释每股收益(元/股)	-0.23	0.39	0.39	-158.97	0.93	0.93
研发投入占营业收入的比例(%)	6.07	5.59	5.59	增加0.48个百分点	4.72	4.72

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	424,645,413.14	558,068,011.41	648,393,145.75	759,734,549.97
归属于上市公司股东的净利润	-49,869,944.15	-29,028,939.84	-41,049,294.47	26,560,291.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-69,100,749.43	-44,658,794.82	-49,608,981.77	1,458,769.35
经营活动产生的现金流量净额	-1,017,056.85	253,616,163.44	175,185,191.05	643,695,289.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,980
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,763
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
浙江甬顺芯电子有限公司	0	74,210,000	18.20	74,210,000	74,210,000	无	0	境内非国有法人
浙江朗迪集团股份有限公司	0	31,000,000	7.60	0	0	无	0	境内非国有法人
显盛(上海)投资管理有限公司-海宁齐鑫炜邦股权投资合伙企业(有限合伙)	-5,676,800	23,323,200	5.72	0	0	无	0	其他
宁波鲸益创业投资合伙企业(有限合伙)	-2,800,000	20,700,000	5.08	0	0	无	0	其他
中意宁波生态园控股集团有限公司	-2,172,000	20,618,000	5.06	0	0	无	0	国有法人
王顺波	0	16,000,000	3.92	16,000,000	16,000,000	无	0	境内自然人
宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	15,250,000	3.74	15,250,000	15,250,000	无	0	其他
宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	14,530,000	3.56	14,530,000	14,530,000	无	0	其他
宁波开投瀚润投资管理合伙企业（有限合伙）-宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	10,000,000	2.45	0	0	无	0	其他
宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	9,845,000	2.42	9,845,000	9,845,000	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中,浙江甬顺芯电子有限公司系宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;浙江甬顺芯电子有限公司、宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人王顺波控制的企业。2.除此之外,公司未知上述前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

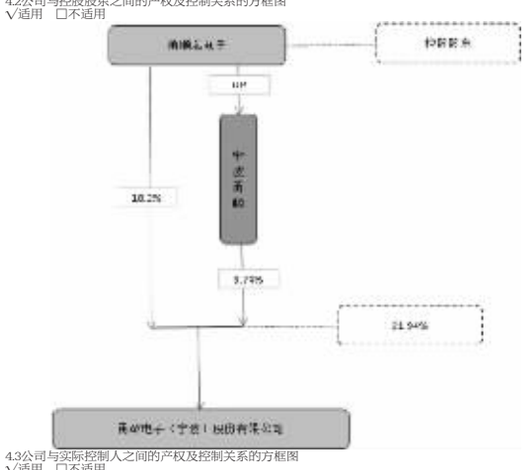
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

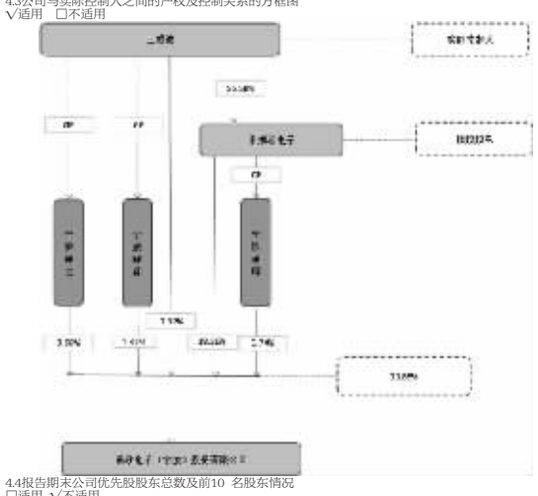
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，公司实现营业收入239,084.11万元，同比增加9.82%；公司归属上市公司股东的净利润为-9,338.79万元,同比减少167.48%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-16,190.98万元,同比减少373%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688362 证券简称:甬矽电子 公告编号:2024-021

甬矽电子（宁波）股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2024年4月17日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年4月3日以书面及电子邮件等方式发出。会议由董事长王顺波主持,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子(宁波)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了以下议案,形成决议如下:

1、审议通过《关于(2023年年度报告)及摘要的议案》

经审议,董事会认为:

(1)公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作,公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,能够客观、真实地反映公司2023年度的经营情况。

(2)公司2023年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

(3)董事会全体成员保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司2023年年度报告》及《甬矽电子(宁波)股份有限公司2023年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于(2024年第一季度报告)的议案》

公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作,公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,能够客观、真实地反映公司2024年第一季度的经营情况。董事会全体成员保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过 。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司2024年第一季度报告》。

3、审议通过《关于(2023年度董事会工作报告)的议案》

2023年度,董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定,积极有效地行使董事会职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于(2023年度总经理工作报告)的议案》

董事会认为该报告真实、客观地反映了公司2023年度总经理工作情况,2023年度管理层有效地执行了董事会各项决议,并结合公司实际情况,开展了各项生产经营活动的情况。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于(2023年度独立董事述职报告)的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在2023年年度股东大会上进行述职。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会听取。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

6、审议通过《关于独立董事独立性评估的议案》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,董事会认为独立董事均不存在违反《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立性要求的情形。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

7、审议通过《关于(2023年度董事会审计委员会履职情况报告)的议案》

2023年度,董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定,勤勉、尽责的发挥审查、监督作用,认真履行董事会审计委员会的职责,编制了《2023年度董事会审计委员会履职报告》《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过 。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》《甬矽电子(宁波)股份有限公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

8、审议通过《关于(2023年度财务决算报告)的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023年度财务决算报告》,真实反映了公司2023年度财务状况和整体运营情况。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过 ,尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

鉴于公司2023年归属于母公司股东的净利润为负,综合考虑公司的经营情况和未来资金需求,为更好地维护全体股东的长远利益,保障公司长期稳定发展,董事会同意公司2023年度拟不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积转增股本,并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过 ,尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-024)。

10、审议通过《关于(2023年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

11、审议通过《关于(2023年度会计师事务所履职情况评估报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

12、审议通过《关于续聘2024年会计师事务所的议案》

经审核,董事会同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司关于续聘2024年会计师事务所的公告》(公告编号:2024-025)。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》

2023年度发生的及2024年度拟预计的日常关联交易属于公司日常生产经营业务,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,交易条件及定价合理、公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的经营独立性,公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

关联董事王顺波对本议案回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-026)。

14、审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

董事会认为公司2024年度董事薪酬方案,结合了公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等,符合公司所

(下转B113版)

证券代码:688362 证券简称:甬矽电子

甬矽电子（宁波）股份有限公司

【2024】第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	726,608,017.68		71.11
归属于上市公司股东的净利润	-35,450,368.36		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,106,397.90		不适用
经营活动产生的现金流量净额	200,813,279.60		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.09		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.09		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.46		增加0.51个百分点
研发投入合计	44,452,271.38		58.04
研发投入占营业收入的比例(%)	6.12		减少0.50个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	13,127,053,438.40	12,330,906,165.46	6.46
归属于上市公司股东的所有者权益	2,385,357,614.63	2,448,597,504.62	-2.58

2024年第一季度,得益于部分客户所处领域的景气度回升、新客户拓展及部分原有客户的份额提升,公司实现营业收入7.27亿元,同比增长71.11%,营收规模大幅提升。毛利率方面,由于营收规模的扩大,规模效应逐渐体现,2024年第一季度整体毛利率为14.23%,同比提升5.84个百分点;净利润方面,受春节假期、公司二期项目建设及人员规模扩大导致的管理费用增加、新增投资使得折旧及财务费用增加、研发投入增加等因素综合影响,本季度整体仍出现一定亏损,但亏损幅度明显收窄,归属于上市公司股东的净利润较去年同期同比改善28.91%。

公司将继续围绕增长目标,一方面继续坚持大客户战略,在深化原有客户群合作的基础上,积极推动包括中国台湾地区头部设计企业的进一步合作,不断提升自身竞争力和市场份额;另一方面,公司将扎实稳健推进Bumping、CP、晶圆级封装、FC-BGA等新产品线,持续提升自身工艺能力和客户服务能力。展望第二季度,公司预期营业收入仍然将维持增长态势。公司将通过市场端和产品端的不断优化,提升自身核心竞争力和盈利能力。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,121.27	使用权资产处置收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	12,996,784.86	系收到的当地政府奖励、专项补助资金等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金